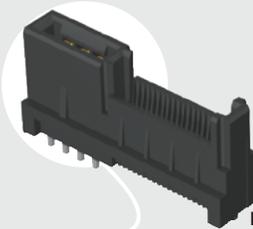




(0.80 mm) .0315"

HSEC8-140-01-L-PV-4-1-WT



HSEC8-120-01-S-PV-2-1

HSEC8-PV SERIES

POWER/HIGH-SPEED EDGE CARD COMBO

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com/HSEC8-PV

- Insulator Material:** Black Liquid Crystal Polymer
- Signal Contact:** BeCu
- Power Contact:** Phosphor Bronze
- Plating:** Au or Sn over 50 μm (1.27 μm) Ni
- Operating Temp:** -55 °C to +125 °C
- Current Rating:** Signal Pin: 3.2 A per pin (2 pins powered)
Power Pin: 27.5 A per pin (2 pins powered)
- RoHS Compliant:** Yes

PROCESSING

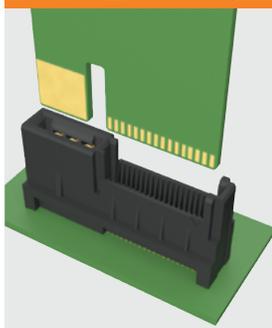
Lead-Free Solderable: Yes

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



APPLICATION



Note: Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

Mates with: (1.60 mm) .062" thick card

Rated up to 60 A per power bank

1 or 2 banks, 2 or 4 positions

EDGE RATE CONTACT

Mates with (1.60 mm) .062" card

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

HSEC8-PV

Rating based on Samtec reference channel. For full SI performance data visit Samtec.com or contact SIG@samtec.com

28 Gbps

HSEC8 - 1 SIG POS - CARD THICKNESS - PLATING OPTION - PV - PWR POS - POWER TAIL - OTHER OPTION

20, 30, 40
(Signal positions per row)

-01
= (1.60 mm) .062" Thick Card

-L
= 10 μm (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail

-2, -4
(Total, 2 per power bank)

1
= Use with (1.60 mm) .062" Thick PCB

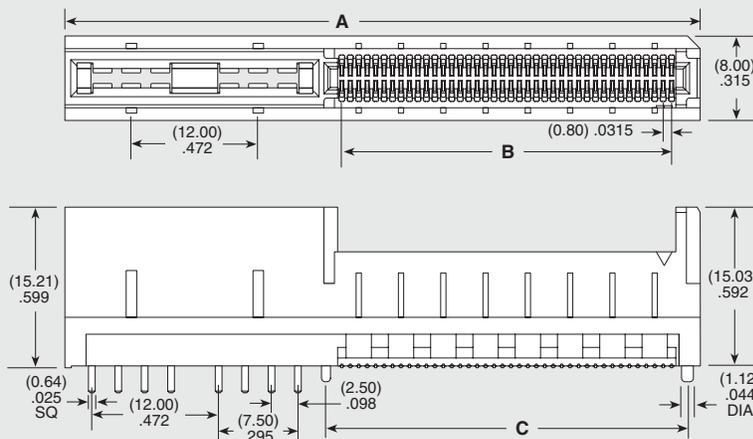
-WT
= Weld Tab

-S
= 30 μm (0.76 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail

-2
= Use with (2.36 mm) .093" Thick PCB

SIGNAL POSITIONS	POWER POSITIONS					
	A (-2)	B (-2)	C (-2)	A (-4)	B (-4)	C (-4)
-20	(32.10) 1.264	(15.20) .598	(18.20) .717	(44.10) 1.736	(15.20) .598	(18.20) .717
-30	(40.10) 1.579	(23.20) .913	(26.20) 1.031	(52.10) 2.051	(23.20) .913	(26.20) 1.031
-40	(48.10) 1.894	(31.20) 1.228	(34.20) 1.346	(60.10) 2.366	(31.20) 1.228	(34.20) 1.346

POWER TAIL	D
-1	(2.35) .093
-2	(3.13) .123



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9